

S-plus エスプラス



多目的プラズマ処理ユニット

特長

+1 処理ユニットと搬送部が独立 顧客のニーズに柔軟に対応

- ・研究、開発では処理ユニット (S-plus C) で、更に搬送ユニット (ST1 or ST2) を取り付けることで量産対応可能 (S-plus T)

+2 RIE・DP 2つのプラズマモードを 切替え可能

- ・用途に応じて様々なプロセスに対応出来ます

+3 限られたスペースにも 導入可能なコンパクトサイズ

- ・フットプリント
W560×D1300 (S-plus C)

●対応品種

- ・ WAFER 2~8インチ
- ・ BGA・CSP

●応用例

- ・レジスト除去 SiO₂、SiN等の微細加工、ポリイミド系樹脂の除去
- ・表面改質によるアンダーフィル性及びワイヤボンディング性の向上



処理ユニット

S-plus C



搬送ユニット

ST1 (WAFER)
ST2 (BGA, CSP)



+

↑
= S-plus T

